

江苏展芯半导体技术股份有限公司

募集资金具体运用情况

经公司第一届董事会第七次和第八次会议、2025 年第三次、第四次临时股东大会审议通过，公司本次拟公开发行人民币普通股不超过 4,112.00 万股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量），实际募集资金扣除发行等费用后，拟按照轻重缓急投资以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金投入金额	审批、核准或备案情况
1	高可靠性电源管理芯片及信号链芯片研发及产业化项目	44,973.14	42,484.68	宁谷管委备 (2025) 215 号
2	总部基地及研发中心建设项目	22,386.76	18,326.63	
3	测试中心建设项目	17,720.61	16,138.79	宁谷管委备 (2025) 143 号
4	补充流动资金	12,000.00	12,000.00	/
合计		97,080.51	88,950.09	

一、本次募投项目具体情况

（一）高可靠性电源管理芯片及信号链芯片研发及产业化项目

1、项目概况

本项目计划研发及产业化数款高可靠性电源管理芯片和信号链芯片，未来将应用于军工电子领域以提高各类型武器装备的信息化水平，包括：新型 LDO 芯片、可并联 DC/DC 芯片、新型漏级调制芯片、运算放大器等，有助于进一步提升公司在模拟芯片领域的自主研发能力，增强科技成果的产业化能力，加强公司的技术水平，扩大产品的应用范围，更好地满足下游客户对产品持续迭代的需求，帮助公司提升盈利规模 and 市场份额。

2、项目建设的必要性

(1) 本项目公司紧抓国产替代机遇，提升产品竞争力，提升品牌影响力的必要举措

集成电路是信息产业发展的关键，我国由于发展起步较晚，在技术积累、创新创造、人才培育等方面较美国、日本、欧洲等国家和地区的企业有较为明显的差距，行业内的主要市场份额大量被国外企业所占据。由于集成电路是国防军工等多个行业的重要发展引擎，自 2018 年国际政治经济环境出现变化开始至今，美国持续发布对中国集成电路行业的限制措施，对我国集成电路供应链的安全造成了一定的影响。另外随着我国加速推进国防和军队现代化的建设，各种现代化的装备快速列装部队，对于集成电路的需求处于持续攀升的态势中。在供需两端的同步催化下，模拟芯片作为集成电路的重要组成部分，作为武器装备实现现代化及智能化的重要保证，将迎来快速发展的新机遇。

公司通过本项目的建设，将进一步产业化多款电源管理芯片，巩固公司在军工电子产业链中的地位，抓住国防军工领域国产替代的机遇，实现公司影响力的提升。

(2) 本项目有助于丰富产品系列，促进迭代升级，拓展更多需求，扩大公司的市场份额

随着我国各类武器装备井喷式发展，信息化及智能化的程度在逐渐加深，单一装备使用的模拟芯片数量在快速增长，同时对芯片的性能、可靠性提出了更高的要求。为进一步丰富公司产品矩阵，并对现有产品进行迭代升级，公司有必要进行本项目的建设，将更多资源投入到高可靠性电源管理类芯片和信号链类芯片的产业化上来，通过招聘更多具有丰富产品研发及落地经验的研发人员，解决下游行业内共同存在的痛点问题，拓宽产品的下游市场覆盖范围，与客户的产品创新保持同步，为公司创造新的利润增长点，优化公司的产品结构，提高抵御风险的能力。

（3）为国家武器装备的发展提供关键元器件支持，满足国防和军队现代化发展的需求

随着我国国防军工行业的发展进入快车道，越来越多的先进武器装备加速列装，这离不开包括模拟芯片在内的各类元器件的支持。各类信息化装备的研发及入役极大地提高了我国国防和军队的整体实力，同时也释放出大量集成电路的需求。模拟芯片作为集成电路的重要组成部分，是装备处理外界数据的第一关，其可靠性和性能水平是装备各技战术指标实现的基础。

公司作为高可靠模拟芯片设计企业，产品已实现在各类武器装备平台上运用，产品质量得到客户的广泛认可。通过本项目的建设，公司将对现有电源管理芯片及信号链芯片的研发、生产及销售团队进行整合，购置具有行业先进水平的软硬件设备，提升公司产品的性能，丰富产品种类，进一步挖掘客户需求，保障好客户关键元器件的供应，满足国防和军队现代化发展的需要。

3、项目建设的可行性

（1）国家对集成电路产业的政策支持为本项目的顺利实施提供政策保障

在信息化数字化的浪潮中，集成电路作为数字化社会的基石，不仅连接着各个产业，也直接影响着国家科技水平和经济实力的竞争力，加快信息化发展、推动各行各业实现数字化转型是我国争取未来发展主动权的必然选择，国家因此出台了一系列推动我国集成电路快速发展的政策措施。

本项目计划产业化的电源管理芯片和信号链芯片是集成电路产业的重要组成部分，项目建成后将为我国的国防军工行业提供更多高可靠性的电源管理芯片和能够解决客户共性痛点的信号链芯片，为国防和军队的现代化建设添砖加瓦。综上，在国家出台相关政策对集成电路产业发展提供大力支持下，本项目具有较好的市场前景，能够为企业产生一定的经济效益，也能够助力国家集成电路的发展，具有政策可行性。

（2）公司客户资源积累深厚，为本项目的产品消化提供支撑

由于公司下游客户所在行业的特殊性，客户在确定某电子元器件的供应商后，为保证终端武器装备质量的高可靠性，在武器装备的服役期内一般不会更换供应

商，另外在考虑元器件的供应稳定、性能需求、质量控制等多方面因素后，客户在新装备研发中也会优先考虑现有供应商名录中的企业。公司在高可靠模拟芯片领域持续多年大力投入，凭借强大的产品研发能力和快速响应的售后服务支持为公司赢得了众多客户的信任，公司丰富的客户资源积累为本项目拟生产产品的顺利消化提供支撑。

(3) 公司深耕模拟芯片领域多年，对行业需求有深刻的理解

公司多年来持续深耕模拟芯片行业，从产品的研发环节、量产环节再到售后保障环节均积累了深厚的经验，竞争优势明显。公司基于“COTS”（货架产品）的研发思路，通过长期深耕行业聚焦于不同客户存在的共性需求，在此基础上进行产品定义，产品性能深度匹配客户需求，保证公司研发生产的产品具有广泛的需求。

本项目计划产业化的芯片种类是公司经过长期市场调研和分析后所确定的，能够解决多个客户的共性要求，产品定位准确清晰，同时公司借助在模拟芯片领域所积攒的技术和人才储备，能够顺利实现产品研发和投产，具有可行性。

4、与发行人现有主要业务、核心技术之间的关系

本项目是公司结合国家产业政策和行业发展趋势，对公司现有主营业务中模拟芯片业务的进一步拓展，符合未来的发展战略和业务发展规划。本项目将以现有的产品技术储备为基础，通过购置具有行业先进水平的软硬设备，并招聘经验丰富的研发人员，对多款电源管理芯片和信号链芯片进行研发及产业化，抓住军工电子行业大力推进国产替代的契机，实现公司业务的进一步扩展。

5、项目投资规划

本项目预计建设期为 4 年，项目总投资 44,973.14 万元，其中工程建设投入 11,469.52 万元，研发费用 26,739.44 万元，基本预备费 764.18 万元，铺底流动资金 6,000.00 万元。具体项目投资明细如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金投资额	占比
1	工程建设投资	11,469.52	8,981.05	21.14%

序号	项目名称	投资总额	募集资金投资额	占比
1.1	土地购置费	505.53	0.00	0.00%
1.2	场地建造费	6,649.05	5,003.14	11.78%
1.3	场地装修费	1,130.17	1,130.17	2.66%
1.4	硬件购置	2,171.51	2,171.51	5.11%
1.5	软件购置	472.74	472.74	1.11%
1.6	其他工程费用	540.52	203.49	0.48%
2	研发费用	26,739.44	26,739.44	62.94%
2.1	研发人员工资	18,899.44	18,899.44	44.49%
2.2	其他研发投入	7,840.00	7,840.00	18.45%
3	基本预备费	764.18	764.18	1.80%
4	铺底流动资金	6,000.00	6,000.00	14.12%
合计		44,973.14	42,484.68	100.00%

6、项目实施主体、实施场地

公司根据自身发展规划和客观情况,通过购置土地并建造房屋的方式获得本项目所需场地,项目选址位于江苏省南京市中国(南京)软件谷安德门大街以西、规划二路以北地块二,东至国有土地;南至规二路;西至国有土地;北至南京市回民殡葬服务所(宗地编号为 320114002005GB00196),公司已通过国有土地出让的方式取得本募集资金投资项目所需的土地使用权。

2024 年 2 月,公司取得南京市规划和自然资源局颁发的“苏(2024)宁雨不动产权第 0002949 号”不动产权证书,宗地面积为 6,612.21 平方米。

7、环保情况

本项目属于芯片设计项目,不会产生工业废水、废气、废渣与噪声等,不会对环境产生污染,不属于环保相关法规规定的建设项目,不需要进行项目环境影响评价。本项目的污染物主要包括废水及固体废弃物,具体污染物类别及处理措施情况如下:

污染物类别	处理方式
废水	本项目废水主要来自生活污水。生活废水经厂内污水预处理设施处理后排入污水管网,送当地污水处理厂处理达标后排放。
固体废弃物	本项目固体废弃物主要来自员工生活垃圾和原材料废弃物等。项目产生固体废弃物由企业专有人人员进行集中收集处理,对于可以二次回收

污染物类别	处理方式
	利用的废弃物进行集中回收处理，对于不可回收的固弃废物由企业委托当地资质单位处理，生活垃圾委托环卫部门处置。

根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021 年版）》，本项目所处行业属于“第五条 本名录未作规定的建设项目，不纳入建设项目环境影响评价管理”，项目建设无需取得环评批复。

8、项目实施进度

序号	时间安排	第一年				第二年				第三年				第四年			
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
1	项目前期工作																
2	土建工程																
3	设备购置及安装调试																
4	人员调配与招募																
5	产品研发及市场推广																

9、项目效益测算

本项目经济效益测算的计算期为 8 年，其中建设期为 4 年。本项目预测财务内部收益率（静态，所得税后）为 20.43%，投资回收期（含三年建设期）为 7.14 年。

（二）总部基地及研发中心建设项目

1、项目概况

本项目将通过购置土地，新建场地用于总部基地和研发中心的建设。本项目建设内容具体包括：

（1）建设总部基地，用于支持公司管理人员和销售人员的日常经营活动开展，为员工提供舒适、稳定的办公环境。

（2）建设研发中心，用于支持公司研发活动的开展，具体包括建设研发实验室和建设研发人员的日常办公场地。

通过本项目，公司将引进更多研发技术人才，壮大研发团队，提升研发实力；同时购置先进的研发设备和软件，以改善现有的研发条件，完善和优化现有研发体系，增强研发效率。建设研发中心有利于加速研发成果的转化应用，增厚公司的技术储备，为企业持续发展注入强大的动力。

2、项目建设的必要性

(1) 建设总部基地是公司吸引更多优秀人才，保障可持续发展的必要举措

建设总部基地是保障公司长期可持续发展的重要战略举措。随着公司业务的不拓展和发展，各项经营活动对办公场地的需求也在不断增加，现有租赁场地的方式步入局限，难以契合未来发展战略的需求。报告期各期末，公司员工总人数分别为 385 人、427 人及 461 人，保持较快的增长速度。现有办公场地均采用租赁方式取得，随着公司业务规模和人员数量持续增长，目前的办公场地空间略显不足，办公场地面积逐渐局限了日常运营活动，且存在租期结束后新场地搬迁、租赁费用上涨等问题。未来公司将引入更多的管理、技术、销售等方面人才，建立稳定的总部基地，可提供更足够的经营空间，更好地满足未来业务规模、人员规模快速增长的场地需求，并为业务发展提供坚实的基础。

(2) 建设研发中心是公司吸引更多技术人才，提升研发实力，增厚技术储备的必要举措

自公司成立以来，始终将自主研发视为企业发展的核心驱动力。通过不断投入研发资源，已在高可靠电源管理芯片和微模块等领域取得了显著的研发成果。而随着公司业务规模不断扩大以及下游客户对产品技术要求日益提高，公司需要持续扩充现有产品品类和规格型号，并不断拓展信号链、MCU、微模块芯片等领域的发展，应对市场竞争，实现公司的可持续发展。

未来大量的新增研发项目将需要更多的研发人员和更完善的研发实验室来保障。通过设立研发中心，公司可以有效整合和集中研发资源，吸引和培养一批高素质的技术人才，适应更大体量研发规模的发展要求。通过设立各类专业化、高水准的研发实验室，一方面可以改善研发人员的实验条件，提供可靠的验证测试手段，提升整体研发实施效率；另一方面有助于加强公司与高校、科研院所等

外部技术资源的对接，形成产学研一体化的创新体系。

（3）本项目有助于完善公司模拟芯片产品布局，丰富产品矩阵，为客户提供更多元化的产品解决方案

军用电子行业具有多品种、小批量的需求特点，公司必须扩大配套范围，才能实现进一步发展，增强公司业绩稳定性。随着军工电子行业发展及各类装备信息化、智能化更新迭代，军用装备的持续升级对于芯片的应用量持续加大，为军工电子行业带来了巨大的市场需求。军工电子企业需要加大研发投入，不断需要产品矩阵，满足广阔的市场需求，不断提升产品性能和品质，使自身在未来市场竞争中取得领先优势。

通过本投资项目建设，公司将继续推进产品创新研发和迭代升级，持续强化公司研发团队，丰富产品矩阵，为客户提供更加多元化的产品解决方案，逐步构建更加多元化的模拟芯片产品结构，增强公司的盈利能力和抗风险能力。

3、项目建设的可行性

（1）公司具备深厚技术积累和优秀的研发人才团队

公司深耕高可靠集成电路和微模块产品，坚持基于自定义产品的正向设计理念进行产品研发，在芯片设计、封装设计、测试筛选等环节以满足高可靠性应用为基本出发点，已形成数百款产品，并形成了一系列技术成果。

公司高度重视研发人才队伍建设，通过内部培养激励与外部吸引的方式持续完善研发团队人才体系。公司研发团队由经验丰富的主要管理人员和核心技术人员组成，他们具有专业的理论知识和丰富的研发经验，对半导体行业的发展趋势有着深刻的理解，对新技术、新产品的研发方向有着明确清晰的规划。公司的深厚技术积累和优秀的研发人才团队为本项目的顺利实施提供了有力支撑。

（2）公司所在城市南京地理位置优越，产业气氛浓厚，研发人才资源丰富

本项目实施地点位于南京市。南京地区的集成电路产业链完整，涵盖了设计、制造、封装测试、设备材料等多个环节。在产业链协同方面，南京市政府积极推动产业链上下游企业的协同发展。通过建立产业联盟、产业园区等方式，促进企

业间的资源共享和技术交流，提高整个产业链的竞争力，并为南京地区培养了大量的专业人才。

本项目的顺利实施需要引进部分匹配公司发展方向的高素质研发人才，而南京地区集成电路企业多，高校科研资源和人才资源丰富，为本项目的实施提供了人才和技术基础。

4、与发行人现有主要业务、核心技术之间的关系

本项目拟建设研发中心和总部运营中心，可对公司现有研发能力和研发资源进行整合与提升，扩充公司研发团队，有助于提升公司整体研发实力和运营效率，亦为公司未来进一步扩大业务规模提供条件。本募集资金投资项目围绕公司主营业务展开，与公司主营业务高度相关。

5、项目投资规划

本项目预计建设期为3年，项目总投资22,386.76万元，其中工程建设投入15,657.57万元，研发费用6,290.24万元，基本预备费438.95万元。具体项目投资明细如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金投资额	占比
1	工程建设投资	15,657.57	11,597.43	63.28%
1.1	土地购置费	824.81	0.00	0.00%
1.2	房屋建造费	10,848.45	8,163.02	44.54%
1.3	房屋装修费	1,843.97	1,843.97	10.06%
1.4	硬件购置	1,117.44	1,117.44	6.10%
1.5	软件购置	141.00	141.00	0.77%
1.6	其他工程费用	881.89	332.01	1.81%
2	研发费用	6,290.24	6,290.24	34.32%
2.1	研发人员工资	4,328.74	4,328.74	23.62%
2.2	其他研发投入	1,961.50	1,961.50	10.70%
3	基本预备费	438.95	438.95	2.40%
合计		22,386.76	18,326.63	100.00%

若公司在本项目实施之前首次公开发行并上市成功，本项目投资所需资金即

通过上市募集资金解决，若公司在本项目实施之后融资成功，则公司将用自筹资金支付项目投资，并在日后用募集资金置换公司先期投入。

6、项目实施主体、实施场地

公司根据自身发展规划和客观情况，通过购置土地并建造房屋的方式获得本项目所需场地，项目选址位于江苏省南京市中国(南京)软件谷安德门大街以西、规划二路以北地块二，东至国有土地；南至规二路；西至国有土地；北至南京市回民殡葬服务所（宗地编号为 320114002005GB00196），公司已通过国有土地出让的方式取得本募集资金投资项目所需的土地使用权。

2024 年 2 月，公司取得南京市规划和自然资源局颁发的“苏（2024）宁雨不动产权第 0002949 号”不动产权证书，宗地面积为 6,612.21 平方米。

7、环保情况

本项目属于芯片设计项目，不会产生工业废水、废气、废渣与噪声等，不会对环境产生污染，不属于环保相关法规规定的建设项目，不需要进行项目环境影响评价。本项目的污染物主要包括废水及固体废弃物，具体污染物类别及处理措施情况如下：

污染物类别	处理方式
废水	本项目废水主要来自生活污水。生活废水经厂内污水预处理设施处理后排入污水管网，送当地污水处理厂处理达标后排放。
固体废弃物	本项目固体废弃物主要来自员工生活垃圾和原材料废弃物等。项目产生固体废弃物由企业专有人员进行集中收集处理，对于可以二次回收利用的废弃物进行集中回收处理，对于不可回收的固弃废物由企业委托当地资质单位处理，生活垃圾委托环卫部门处置。

8、项目实施进度

本项目建设期为 3 年，第一年完成土地购置，开始场地建设及装修，第二年开始设备购置及安装调试，随后开展研发人员调配、招聘及培训，陆续实施研发项目。

序号	时间安排	第一年				第二年				第三年			
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
1	项目前期工作												

序 号	时间安排	第一年				第二年				第三年			
2	土建工程												
3	设备购置及安装调试												
4	人员调配与招募												
5	研发工作开展												

(三) 测试中心建设项目

1、项目概况

本项目将通过购置土地新建用于测试中心的场地，并新购置一批测试设备，并配置测试及质量工程师团队，扩大对模拟芯片产品的测试能力。同时，本次测试中心建设将引入无人运输车、机械手、视觉检测等自动化设备，大大提升测试产线的自动化水平，一方面可以间接提高产线的测试效率，另一方面减少了人工参与的不稳定性影响，可以大大提高测试结果的可靠性。此外，本次测试中心建设还包括加大自动化相关的硬件工程和软件系统的研发投入，以进一步提升生产的信息化水平，实现精细化生产，形成自动化、无人化、智慧化的现代化智慧工厂。

2、项目建设的必要性

(1) 有助于公司提高测试能力，确保公司测试产能及交付能力，保障未来发展

筛选测试作为军工电子生产中最重要的一环之一，对于确保产品质量和可靠性具有至关重要的作用。通过进行严格的筛选测试，可以发现潜在的缺陷和故障，并筛除不良品，以确保向客户供应的产品均符合其严格的质量标准要求，是保障军工电子企业生存的基础，也是推动企业持续发展的关键。

公司目前已有测试中心，基本能够满足现有业务规模的测试需求，但受限于现有租赁场地的规划限制以及场地面积较小，导致现有设备的布局较为拥挤，影响了操作和维护效率，对场地扩展的需求非常迫切。未来随着公司业务规模进一步扩大，仅靠现有测试能力难以有效支撑未来的业务发展规划，因此迫切需要对测试中心场地进行扩展。

本投资项目建成后将提升公司的测试能力和自动化水平，以更好地适应未来几年业务体量增长对测试能力的要求，项目建设具有必要性。

（2）本投资项目是加大生产系统研发投入，推动系统功能升级，实现向智慧化生产转型升级的重要举措

建设智慧化的测试工厂可以实现自动化和智能化的测试过程。通过引入人工智能、大数据分析和自动化控制等技术，可以实现对测试数据的实时监测和分析，及时发现潜在问题并进行优化调整，有助于提高测试的效率和准确性，降低人为错误的风险，并节省人力资源成本。此外，建立一个完善的测试数据管理系统对促进公司产品可靠性的提升至关重要，通过持续获取和收集各项测试数据，有利于研发人员对产品失效原因进行及时有效地分析，以便改善模拟芯片设计和制造良率。

本投资项目建成后将进一步增强公司的产品质量控制，提升测试筛选的智能化水平，有助于巩固和增强公司在市场竞争中的地位，项目建设具有必要性。

3、项目建设的可行性

（1）公司在测试环境深厚的技术积累和实践经验

公司已具备成熟的测试产线运营经验，拥有完备的筛选检测设备、专用工装夹具、筛选检测领域核心技术，可以高质量地完成军工级筛选检验。目前相关测试环节涵盖了内部目检、温循、老炼、ATE 测试、三温测试、AOI 检测、超声检测、X 射线检查等筛选流程，以确保产品的电参数、环境适应性、机械应力、结构特性及稳定性符合军工行业的要求。目前公司的检测能力可满足自身绝大多数国军标检测需求，对于少数非常规检测项目，公司选取拥有权威资质的第三方检测机构进行委外测试，以保障公司产品的质量控制。此外，公司实验室检测能力通过中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认定，公司已建立了多个产品质量等级序列，可满足客户各类质量等级的产品需求。公司在测试筛选方面的技术积累和实践经验将为本项目的顺利实施提供可靠保障。

（2）公司具备技术人才储备作为实施基础

测试团队方面，公司汇集了一批专业知识扎实、实践经验丰富、创新能力强

的高素质测试工程师，培育了一支具有丰富测试经验的团队，在长期的产品测试过程中，积累了扎实的测试硬件工程和软件系统开发的功底和测试产线运营经验。此外，公司还拥有具备软硬件开发能力的技术人才，可持续开发和改进现有生产系统，以提高其稳定性、可靠性和效率。综上，公司的技术人才储备将为本投资项目的实施提供坚实基础。

(3) 公司丰富的客户资源为测试产能消化提供可行性基础

报告期内，公司服务客户数量超过 1,600 家，形成了较为稳定的客户资源积累。军工行业客户在确定电子元器件供应商后，为保证武器装备质量高可靠性，通常不会轻易更换供应商。此外，公司下游客户以央企军工集团下属科研院所及公司为主，客户商业信用和资质良好，公司的优质客户资源有利于本投资项目新增测试产能的消化。

4、与发行人现有主要业务、核心技术之间的关系

本项目是对公司测试筛选能力的综合提升，测试筛选作为公司主营产品质量控制的重要环节，本投资项目的实施有助于提升公司测试筛选的效率和自动化水平，有利于缩短产品交付排期，提升客户满意度，为公司未来进一步扩大业务规模提供保障。公司在测试筛选方面具备实践经验积累，同时亦已具备测试相关的授权发明专利，本募集资金投资项目围绕公司主营业务展开，与公司主营业务高度相关，公司亦已具备项目实施的技术积累。

5、项目投资规划

本项目预计建设期为 2 年，项目总投资 17,720.61 万元，其中工程建设投入 17,373.15 万元，基本预备费 347.46 万元。具体项目投资明细如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金投资额	募资额占比
1	工程建设费用	17,373.15	15,791.33	97.85%
1.1	场地投资	11,498.10	9,916.28	61.44%
1.1.1	土地购置	1,581.82	0.00	0.00%
1.1.2	场地建造	8,553.57	8,553.57	53.00%
1.1.3	场地装修	1,362.71	1,362.71	8.44%

序号	项目名称	投资总额	募集资金投资额	募资额占比
1.2	软硬件投资	5,875.05	5,875.05	36.40%
1.2.1	硬件设备购置	5,644.59	5,644.59	34.98%
1.2.3	软件购置	230.46	230.46	1.43%
2	基本预备费	347.46	347.46	2.15%
合计		17,720.61	16,138.79	100.00%

若公司在本项目实施之前首次公开发行并上市成功，本项目投资所需资金即通过上市募集资金解决，若公司在本项目实施之后融资成功，则公司将用自筹资金支付项目投资，并在日后用募集资金置换公司先期投入。

6、项目实施主体、实施场地

公司根据自身发展规划和客观情况，通过购置土地并建造房屋的方式获得本项目所需场地。宗地坐落于江苏省南京市中国（南京）软件谷宁丹路以西、许家村路以北地块，东至宁丹路，南至许家村路，西至定坊村农民集体，北至定坊村农民集体（宗地编号为 320114006003GB00080）。

2025 年 8 月，公司取得南京市规划和自然资源局颁发的“苏（2025）宁雨不动产权第 0018162 号”不动产权证书，宗地面积为 8,898.42 平方米。

7、环保情况

本项目属于芯片设计项目，不会产生工业废水、废气、废渣与噪声等，不会对环境产生污染，不属于环保相关法规规定的建设项目，不需要进行项目环境影响评价。本项目的污染物主要包括废水及固体废弃物，具体污染物类别及处理措施情况如下：

污染物类别	处理方式
废水	本项目废水主要来自生活污水。生活废水经厂内污水预处理设施处理后排入污水管网，送当地污水处理厂处理达标后排放。
固体废弃物	本项目固体废弃物主要来自员工生活垃圾和原材料废弃物等。项目产生固体废弃物由企业专有人人员进行集中收集处理，对于可以二次回收利用的废弃物进行集中回收处理，对于不可回收的固弃废物由企业委托当地资质单位处理，生活垃圾委托环卫部门处置。

8、项目实施进度

本项目建设期为 2 年，第一年完成土地购置，开始场地建设及装修，第二年

开始设备购置及安装调试，随后开展测试人员的调配、招募、培训，年底测试线投产运行。

序号	时间安排	第一年				第二年			
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
1	项目立项								
2	土地购置								
3	场地建造及装修								
4	测试设备购置及安装调试								
5	测试人员调配、招募、培训								
6	测试线运行								

(四) 补充流动资金项目

1、项目概况

公司拟本次募集资金中的 12,000.00 万元用于补充流动资金，为公司日常生产经营发展提供资金支持。

该投资项目不涉及固定资产投资，无需履行审批、核准及备案程序，不涉及对环境造成重大影响的情形，无需办理环境影响评价审批手续。本项目实施主体为江苏展芯，不涉及实施地点及土地。

2、项目建设的必要性

报告期内，公司营收规模保持快速增长趋势，预计未来随着新产品研发和产品矩阵的进一步丰富，公司的收入规模将继续增长。而随着公司业务规模不断增长，公司流动资金的需求亦随之提升，为保障公司日常营运需要，公司需要一定规模的流动资金，以保障公司的业务开展及研发活动实施。

3、项目建设的可行性

公司已经建立了较为完善的资金管理和使用制度，公司依据自身业务发展情况、行业特性，基于资产和负债周转率等数据，对日常生产经营所需流动资金的规模进行测算，谨慎确定本次补充流动资金项目的规模。如未来实际流动资金需求高于本次补充流动资金项目规模，公司可通过银行贷款或其他方式融资作为补

充，本投资项目具有可行性。

（本页无正文，为《江苏展芯半导体技术股份有限公司募集资金具体运用情况》之盖章页）


江苏展芯半导体技术股份有限公司
2026年7月17日